

# (開発品) 放熱性接着剤

熱伝導性が高く、絶縁性を持ち、常温硬化可能

2液を混ぜることで常温硬化するため加熱設備が不要。  
ヒートシンクやLiBの固定に。

## 製品の特長

### ▶ 熱伝導性をさらに向上

従来品より高い3.7W/m・Kを実現しました。

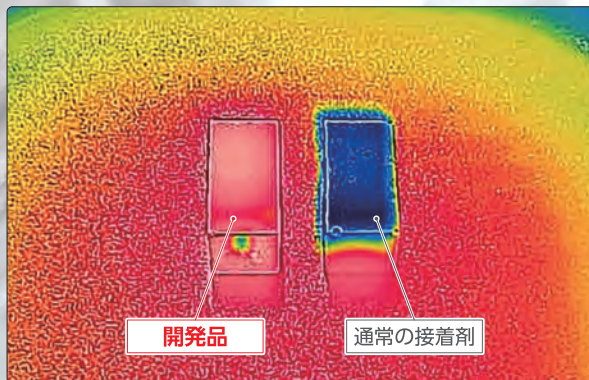
### ▶ 強靱な接着力

エポキシ樹脂系接着剤を基材としているため強力に接着します。

### ▶ シロキサン不含有

接点障害の原因であるシロキサンを含みません。

#### ● 良好な熱伝導性



## 性状性能

### ▶ 一般性状

|                | 開発品 |     | 従来品    |       |
|----------------|-----|-----|--------|-------|
|                | 主 剤 | 硬化剤 | 主 剤    | 硬化剤   |
| 配合比 (重量比)      | 100 | 100 | 100    | 100   |
| 色              | 白色  | 白色  | 灰色     | 白色    |
| 粘度 (mPa・s)     | パテ状 | パテ状 | 100000 | 95000 |
| 比 重            | 3   | 3   | 2.8    | 2.7   |
| 硬化時間 (h) (25℃) | 24  |     | 24     |       |

### ▶ 硬化物物性

| 項 目                          | 開発品               | 従来品               |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 熱伝導率 (W/m・K)                 | 3.7               | 2.1               |
| 表面抵抗率 (Ω・cm)                 | >10 <sup>14</sup> | >10 <sup>14</sup> |
| 体積抵抗率 (Ω・cm)                 | >10 <sup>14</sup> | >10 <sup>14</sup> |
| 誘電率                          | 1MHz : 5.3        | 1MHz : 4.5        |
| 誘電正接                         | 1MHz : 0.014      | 1MHz : 0.009      |
| 硬度 (HDD)                     | 92                | 92                |
| 引張せん断強度 (N/mm <sup>2</sup> ) | 11                | 17                |
| 難燃性                          | UL-94 V-0相当       | UL-94 V-0相当       |

